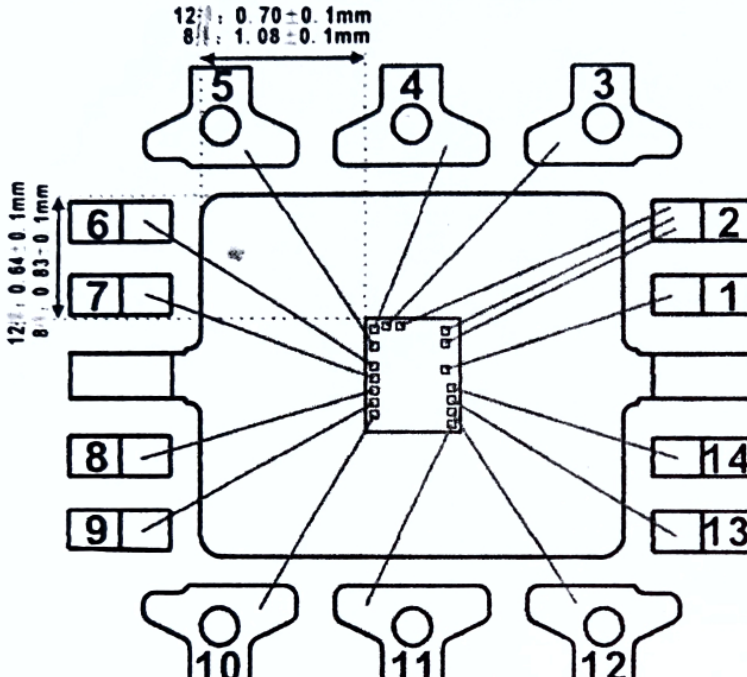
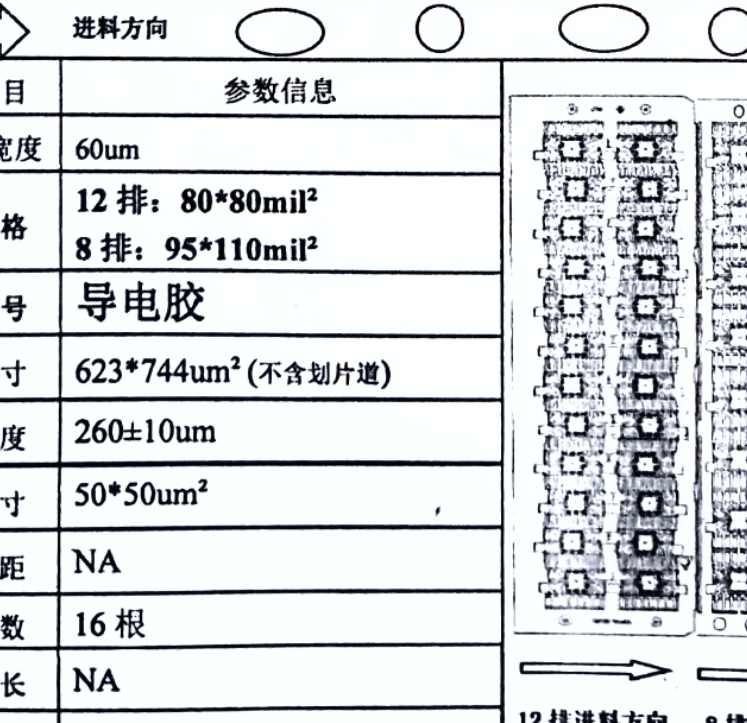
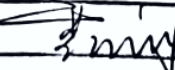

 山东汉芯科技有限公司 ShanDong HanXin Technology Co., Ltd TEL:0632-7528601 FAX:0632-7528604		文件编号		BD-HXQ73-SOP14005											
		文件名称		SOP14L 焊线图											
芯片型号		HS5158		产品名称		HS2247PT		客户代码		HXQ73		版本		A	
版本信息:															
版本		修改内容								修改日期		修改人			
A		初版发行								2024-11-07		卢圣琼			
<div>进料方向</div> <div></div>															
<div>进料方向</div> <div></div>															
项 目		参数信息				<div>备注:</div> <div>PAD(焊盘)铝层厚度: 1um</div> <div>PAD 下方是否有敏感器件? <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无</div> <div>客户注意:</div> <div>焊接时, PAD 下方或附近有敏感器件时, 压焊会影响成品率和可靠性。</div> <div><input type="checkbox"/> 试产 <input type="checkbox"/> 直接量产 (直接量产我司不予保证良率)</div> <div>客户确认签字: 徐挺 2024.11.08</div>									
划片道宽度		60um													
框架规格		12 排: 80*80mil ² 8 排: 95*110mil ²													
粘胶型号		导电胶													
芯片尺寸		623*744um ² (不含划片道)													
芯片厚度		260±10um													
焊点尺寸		50*50um ²													
焊点间距		NA													
焊线根数		16 根													
焊线总长		NA													
焊线线径		合金线/20um													
制 定		卢圣琼		审 核				批 准							
制 定 日期		2024-11-07		审 核 日期		2024.11.08		批 准 日期		2024.11.08					